

Features

高度な基板設計、パッケージ設計から試作、量産まで一貫したサービスを提供します。

- ▶ カスタムボール数に対応
- ▶ ボールピッチ : 0.80~1.27 mm
- ▶ ボディサイズ : 21~35 mm
- ▶ 細線Auワイヤ/Cuワイヤ対応
- ▶ チップ・オン・チップ (CoC)
- ▶ 品質を向上させ得る大型モールドキャップ
- ▶ 薄型、軽量
- ▶ 熱特性および電気特性の改善
- ▶ デバイスのパフォーマンスおよびシステム互換性のためのシグナル、パワーおよびグランド配線の柔軟性
- ▶ HDIデザイン利用可
- ▶ マルチチップ (MCM) および表面実装の構造に最適な基板
- ▶ ストリップベースの製造プロセス実績
- ▶ ボール配置 : ペリフェラル、スタagger およびフルアレイ対応
- ▶ 多層、グラウンド/パワー
- ▶ 高信頼性
- ▶ Pbフリーはんだボール対応

PBGA

J-Devicesの幅広いラインアップのPlastic Ball Grid Array (PBGA) は、お客様の様々なニーズに対応したソリューションを提供します。低インダクタンス、熱特性の改善など、電気特性および熱特性に配慮した最適な設計ソリューションを提供します。

Thermally Enhanced PBGA (TEPBGA)

低熱抵抗対応のオプションとしてヒートスラグ内蔵タイプもラインアップしています。

Applications

- ▶ TV、ゲーム、ネットワーク、自動車向けおよび産業向けアプリケーション
- ▶ 多ピン、高密度、高放熱および高い電気的性能が求められるアプリケーション

Thermal Performance

Body Sizes (mm)	θJA at 1.0W 0 Airflow (°C/W)	
	PBGA	TEPBGA
23	18.6	14.2
27	16.9	13.7
31	16.0	12.4
35	15.5	11.9

*他の熱データも準備可能です
 *チップサイズ 8.0 x 8.0 mm
 *チップ厚 0.29 mm
 *Ta 25°C

Reliability Qualification

- ▶ 耐湿レベル : 前処理条件 30°C/60% RH, 192 hours, IR reflow 260°C 3X
- ▶ uHAST: 130°C/85% RH, 96 hours
- ▶ TC : -55°C/+125°C、1000 cycles
- ▶ HTS : 150°C、1000 hours

Process Highlights

- ▶ チップ厚 : 0.29 mm
- ▶ ボンディングパッドピッチ : 40 μm
- ▶ Auワイヤ径 : 15~23 μm
- ▶ Cuワイヤ径 : 18~23 μm
- ▶ マーキング : レーザーマーク
- ▶ ウェノバックグラインディング : 対応可

PBGA

Standard Materials

- ▶ パッケージ基板
 - ▷ 導体層：Cu
 - ▷ 絶縁層：エポキシ樹脂（ガラスクロス）
- ▶ ダイアタッチ：導電性エポキシ
- ▶ モールド樹脂：エポキシモールド
- ▶ はんだボール：Pbフリー

Test Services

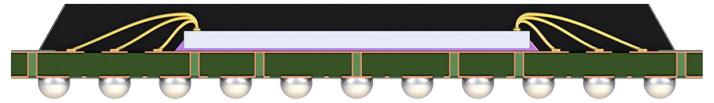
- ▶ プログラム変換
- ▶ 量産エンジニアリング
- ▶ ウェハプローブ
- ▶ 256ピン x 20MHzテストシステム対応
- ▶ -55°C to +125°Cテスト対応
- ▶ バーンイン対応

Shipping

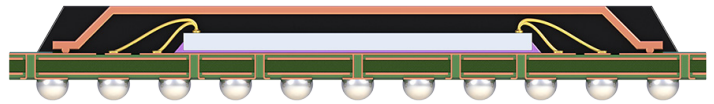
- ▶ JEDECトレイ
- ▶ テープ&リール

Cross-section

PBGA

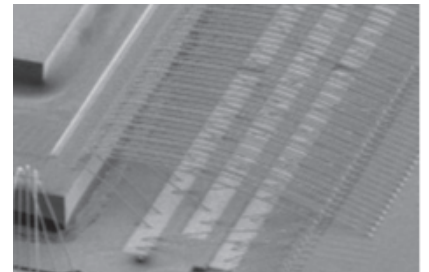
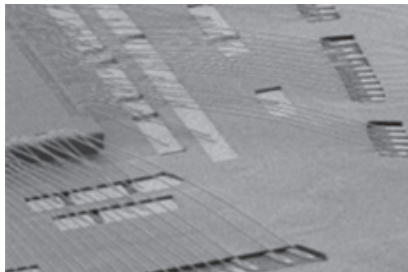


TEPBGA



TEPBGAはチップからヒートスラグへ直接熱を伝える構造であり、放熱性に優れています。

Wire Images



詳細についてはamkor.comにアクセス、またはsales@amkor.com までメールをお送りください。

本文中の情報に関して、Amkorはそれが正確であることまたはかかる情報の利用が第三者の知的権利を侵害しないことについて、いかなる保証もしません。Amkorは同情報の利用もしくはそれに対する信頼から生じたいかなる性質の損失または損害についても責任を負わないものとし、また本文書によっていかなる特許またはその他のライセンスも許諾しません。本文書は、いかなる形でも販売の標準契約条件の規定を超え、いかなる製品に対しても、Amkorの保証を拡張させ、または変更することはありません。Amkorは通知することなくいつでもその製品および仕様に変更を行う権利を留保します。Amkorの名前とロゴはAmkor Technology, Inc.の登録商標です。記載されている他の全ての商標はそれぞれの会社の財産です。

© 2018 Amkor Technology Incorporated. All Rights Reserved. DSJD401C Rev Date: 10/18